

SID

Werk: Rot am See

Artikel:

547

ML8

Erstellt:

Kracht, Enrico

Kunde:

Datum:

29.09.2015



Prozesstechnik: B: undefiniert

Materialtext	Mat. Nr.	µm	Aufbau	Prozessaufbau
A-RS Kupferfolie-018my 330x490mm	50200238	18	VS	1
A-RS-FR4-Prepreg-1080-TG150-HF	50200641	130		2
A-RS-FR4-Prepreg-1080-TG150-HF	50200641	0		3
A-RS-FR4-ML-0.25mm-018+018-TG150-HF	50200928	18	L2	4
		254		
		18	L3	
A-RS-FR4-ML-0.25mm-018+018-TG150-HF	50200928	18	L4	7
		254		
A-RS-FR4-ML-0.25mm-018+018-TG150-HF	50200928	18	L5	10
		254		
A-RS-FR4-ML-0.25mm-018+018-TG150-HF	50200928	18	L6	11
		254		
A-RS-FR4-ML-0.25mm-018+018-TG150-HF	50200928	18	L7	12
		254		
A-RS-FR4-ML-0.25mm-018+018-TG150-HF	50200928	18	RS	13
		254		

Dicke nach Verpressen

B00:

1440 µm

Tol+:

155 µm

Tol-:

155 µm

Dmax:

1595 µm

Dmin:

1285 µm

Gesamtdicke über alles

0 µm

Tol+:

0 µm

Tol-:

0 µm

Dmax:

0 µm

Dmin:

0 µm

Kundenforderung

Dicke (D):

1550 µm

Tol+:

155 µm

Tol-:

155 µm

Dmax:

1705 µm

Dmin:

1395 µm

Messstelle: (05) über LM und galv.Cu; beidseitig

nominal:

1496 µm

Version 1.2.14.14

© Würth Elektronik